

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-100

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 关于筹划收购北一半导体科技（广东）有限公司控股权 暨签署《收购意向协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2025年8月28日与北一半导体科技（广东）有限公司（以下简称“北一半导体”或“标的公司”）及其股东北芯科技（天津）有限公司（以下简称“北芯科技”）、YU UNYONG（韩国籍自然人）签署了《收购意向协议》，拟通过现金方式收购北一半导体不低于51%的股权，取得其控股权，具体投资方案和投资比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，北一半导体将成为公司控股子公司。

2、本次签署的《收购意向协议》系各方就收购事宜达成的初步意向协议，旨在表达各方合作意向。本次交易尚处于初步筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，交易的具体方案尚需交易各方进行进一步的协商和论证，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

3、标的公司100%股权的整体估值最终以评估报告和正式签署的收购协议为准。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。

6、公司将根据相关法律法规的规定履行交易进展情况持续信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 一、本次收购标的公司概述

北一半导体是专注于新型功率半导体模块研发、生产、封装、测试、销售及服务的国家高新技术企业。主营业务涵盖 IGBT、PIM、IPM 等功率半导体元器件，产品可应用于新能源汽车、工业控制、工业机器人、光伏、风力发电及储能等领域。北一半导体拥有 16,500 平方米的 IGBT 模块生产基地，配备 9 条全自动及半自动封装产线，并拥有 170 余台（套）国内外先进设备。

目前，北一半导体正积极推进自主流片晶圆工厂项目建设（一期），主要生产 6 英寸和 8 英寸流片。此外，新建 3 万平方米工厂将专注于碳化硅 MOSFET、DSC 双面散热和 SSC 单面散热模块的生产。

北一半导体核心团队在功率半导体、电力电子、电气工控等领域拥有丰富经验，持续提升 IGBT 芯片设计与模块封装技术。现已取得国内外多项授权专利（含韩国、美国）及软件著作权，具有较强的研发实力。北一半导体紧密围绕产业发展需求布局，逐步形成了完整的功率半导体产业链。

2025 年 8 月 28 日，公司与北一半导体及其股东北芯科技、YU UNYONG 签署《收购意向协议》，拟以现金方式收购北一半导体不低于 51% 的股权，实现对标的公司的控股之目的，标的公司 100% 股权的整体估值最终以评估报告和正式签署的收购协议为准。

本次签署的《收购意向协议》系各方就收购事宜达成的初步意向协议，旨在表达各方合作意向。本次交易尚处于初步筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，交易的具体方案尚需交易各方进行进一步的协商和论证，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对手方基本情况

### （一）对手方一

- 1、名称：北芯科技（天津）有限公司
- 2、注册资本：1,600 万元人民币
- 3、法定代表人：金明星
- 4、成立日期：2015 年 4 月 14 日

5、统一社会信用代码：911201103286397566

6、公司住所：天津市东丽区万新街雪莲路西16号F6号房屋207A室

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；集成电路设计；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；企业管理咨询；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、股权结构：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	金明星	800.00	50.00
2	李承贤	768.00	48.00
3	王玲	32.00	2.00
合计		<b>1,600.00</b>	<b>100.00</b>

（二）对手方二

YU UNYONG，男，韩国国籍，护照号码：M55\*\*\*\*\*

截至本公告披露日，经查询中国执行信息公开网信息，上述交易对方未被列为失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。

最近三年，公司与上述交易对方未发生过类似交易情况。

### 三、标的公司基本情况

（一）基本情况

1、名称：北一半导体科技（广东）有限公司

2、注册资本：6,031.144026 万元人民币

3、法定代表人：金明星

4、成立日期：2020年12月25日

5、统一社会信用代码：91440300MA5GJNKY25

6、公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路12号天安数码城天祥大厦十层B1-B2

7、经营范围：计算机软件的开发与销售；货物及技术进出口业务（法律、

行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售。计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）电子元器件及电子设备的设计、研发、制造与销售。检验检测服务；安全生产检验检测；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

## （二）股权结构

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	北芯科技（天津）有限公司	2,498.87	41.43
2	YU UNYONG	570.00	9.45
3	其他股东	2,962.27	49.12
	合计	<b>6,031.14</b>	<b>100.00</b>

## 四、收购意向协议的主要内容

### 1、协议签订主体：

- （1）甲方（收购方）：康达新材料（集团）股份有限公司；
- （2）乙方一：北芯科技（天津）有限公司；
- （3）乙方二：YU UNYONG；
- （4）丙方（标的公司）：北一半导体科技（广东）有限公司。

### 2、本次收购概述：

截至本协议签订之日，乙方合计持有标的公司 50.88% 股权，除乙方外其他丙方股东（以下简称“财务投资人”）合计持有标的公司 49.12% 股权。

在满足本协议及届时正式交易文件（结合实际情况需要，包括但不限于投资协议、股权转让协议、标的公司更新后章程等，统称“正式交易文件”）约定相关条件的情形下，收购方拟实施本次收购。

经各方初步协商，收购方拟以现金方式收购标的公司届时股东（“出售方”）所持合计不低于 51% 股权（对应标的公司人民币 3,075.88 万元注册资本，“标的股权”），以实现对标公司的控股。

### 3、先决条件：

(1) 收购方及其委托的中介机构（包括律师事务所、审计机构、评估机构等）已完成对标的公司的尽职调查，并认为标的公司及标的股权不存在重大瑕疵，且届时参与本次收购的交易各方（包括收购方、出售方、标的公司及其实际控制人等，统称“交易各方”）已根据收购方尽职调查结果就相关事项和解决方法及本次收购的最终方案达成一致意见；

(2) 交易各方已经依据证券监管、信息披露等各方面的法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所、行业主管机构、国有资产管理部门等各有权部门的监管要求，获得必要的主管部门的批准文件或证明（如需）；

(3) 交易各方已根据各自适用的法律、法规、规则、章程等规定就本次收购完成内部批准程序，并取得了各自相应的授权和批准；

(4) 截至本次收购先决条件满足之日，标的公司按照正常及既往的方式管理业务，没有对标的公司整体估值产生重大不利影响的情形发生，包括但不限于标的公司业务、财务状况以及股权结构等方面（事先已经交易各方同意的除外）；

(5) 收购方根据尽职调查情况而合理提出的其他条件。

#### 4、定价方式：

各方同意，标的公司在本次收购中的估值以及标的股权的收购对价，将结合收购方尽职调查工作结果，以收购方聘请的资产评估机构出具的《资产评估报告》所确定的评估值为依据，由交易各方协商确定，并以正式交易文件约定为准。

#### 5、排他条款：

在本协议有效期内，乙方及丙方应保证标的公司的股权结构稳定（本协议已有约定或经甲方事先书面同意的除外），同时保证不与其他上市公司或投资方进行以出售标的公司股权（包括增资等）为事由的接触，并且不进行与本次收购存在利益冲突的事项。

#### 6、违约责任：

(1) 对违约方发生的违约行为，守约方可以在知晓该违约行为后二十个工作日内书面通知对方纠正违约行为或进行协商解决，如在守约方发出书面通知后的三十日内未纠正违约行为或协商未果，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任并赔偿其损失。

(2) 如乙方或丙方违反排他条款约定的，收购方有权单方放弃/终止本次收

购，且乙方及丙方应向收购方支付人民币 3,000 万元的违约金，并承担收购方因本次收购发生的中介机构费用。

(3) 在收购方完成尽职调查工作后认为标的公司不存在重大瑕疵，且最终确认的本次收购之具体条件较本协议之约定未有实质性变化的前提下，任何一方不得单方面拒绝达成并签署正式交易文件；否则，守约一方有权要求违约方就该违约行为承担人民币 3,000 万元的违约金，并承担守约方因本次收购发生的中介机构费用。

#### 7、适用法律及争议解决：

本协议的订立、履行、效力、解释、争议及纠纷的解决均适用中国法律。因本协议产生的争议，各方应通过友好协商解决。若在争议发生后未能通过友好协商解决，则任何一方可将该争议提交上海仲裁委员会裁决。仲裁裁决是终局的，对各方均具备约束力。

#### 8、生效及其他：

(1) 本协议自各方有效签署之日起生效，且有效期为生效之日起满六个月止。

(2) 因本协议项下交易而必须支付的中国法定税项及按照必要程序而支出的费用和开支应由各方按中国法律的规定自行承担。但届时收购方如因其他方违约行为而决定放弃/终止本次收购的，则收购方因本次收购事宜而产生的相关中介费用由具体违约方承担。

(3) 本协议仅为本次收购的意向协议，届时各方/交易各方履行本次收购应以最终签订的正式交易文件为准。

(4) 如收购方聘请的中介机构在审计和法律尽职调查过程中发现标的公司存在对本次收购可能构成实质障碍的事项，且经各方/交易各方协商仍无法将该等实质障碍排除时，则收购方有权经书面通知其他方解除本协议并无需承担违约责任。

### 五、本次交易的目的和对公司的影响

在“新材料+电子科技”的战略引领下，公司正稳步推进布局，拟通过此次收购，加速半导体产业布局，吸纳集新型功率半导体模块研发、生产、封装、测试、销售及服务于一体的优质资产。为优化业务结构、提升核心竞争力，公司结

合自身发展战略与行业趋势，计划在现有业务基础上持续推动战略转型升级。交易完成后，北一半导体将纳入公司合并报表，有望为公司带来新的收入与利润增长点，增强盈利能力与持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

作为国有控股企业，公司以现有半导体材料产业布局（CMP 抛光液、溅射靶材、LTCC 陶瓷材料、电子化学品等）为基础，通过多元化投资模式，加速向半导体产业战略转型升级，努力打造第三增长曲线。

半导体产业作为国家战略性新兴产业，市场需求持续增长，发展前景广阔。公司以聚焦关键领域技术攻坚、实现核心技术自主可控、填补国内空白为己任，立足“硬科技”，依托前期布局，与北一半导体将围绕半导体 IDM 及高端功率半导体器件业务的核心环节，加大研发投入与资源整合力度，持续提升从半导体设计、制造到封测及下游分立器件（含 IC、IGBT）的一体化业务能力，力争在相关领域实现突破，为公司长远发展注入新动能。公司战略布局高度契合国家产业政策导向，符合公司长远发展和战略规划。

本次交易不涉及发行股份购买资产，对公司的股权结构不构成影响；交易完成后，预计公司的营业收入及净利润水平将进一步提高，公司抗风险能力将得到有效增强。

## 六、风险提示

1、本次签订的意向协议书仅为双方基本意愿的意向性约定，交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，最终交易方案尚需公司、标的公司及交易对手方履行必要的内外部相关的决策审批程序，本次交易存在不能达成正式协议及协议未能通过决策审议而终止的风险，交易能否最终实施存在重大不确定性。

2、公司将严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

1、《收购意向协议》。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日